

[会員限定] 2025年度第2回 先端半導体パッケージWG研究会

【会場】大阪大学産業科学研究所
インキュベーション棟1階 講義室 (I-117)

2025年 受付13:00～
6/27 (金) 13:30～18:00

13:30-13:35

開会挨拶 菅沼克昭 所長・特任教授 大阪大学産業科学研究所F3D実装協働研究所

13:35-14:35

米国半導体戦略動向 ～チップス法、インテル、TSMC アリゾナ…～

講師：亀和田忠司氏 AZ Supply Chain Solutions (AZ サプライチェーンソリューションズ) オーナー

ハイブリッド

チップス法が施行されて3年、アメリカが半導体製造回帰を推し進めて来たなか、かつての覇者インテルは3兆円近い赤字を出す事態に陥っている。新しい王者のTSMCはアメリカに総額20兆円以上を投入し先端技術 (<2nm) の3分の1のアメリカ生産を計画している。目まぐるしく変化するアメリカ半導体の最新動向を考察する。



14:35-15:35

ホームサービスロボットの最新動向と異種混合レザバーチップの可能性

たむこう はかる

講師：田向 権氏 国立大学法人 九州工業大学 大学院 生命体工学研究科
人間知能システム工学専攻 教授
ニューロモルフィックAIハードウェア研究センター副センター長

ハイブリッド

家庭やオフィスなど人間の生活空間で活躍するホームサービスロボットの研究開発動向を、ロボット世界大会6勝の九工大チームの事例をベースに解説する。また、AIの電力問題解決のために研究開発を進めているレザバーチップの現状を紹介し、アナログ不揮発メモリベースのインメモリ計算や先端デジタル部を組合わせた将来の異種混合パッケージ化に関する実現可能性について、アプリ(ロボット応用)観点の要求をベースに議論する。



15:35-15:45 休憩・講師との名刺交換会

15:45-16:45

次世代半導体パッケージ向け各種材料レーザ加工について
及びピアメカニクスレーザ加工機のご紹介

講師：伊藤 靖氏 ピアメカニクス株式会社
レーザ設計本部 事業開発部 部長

対面のみ

近年、半導体の性能を高めるため、たくさんの電子回路を積層するチップレット積層半導体パッケージの開発が進められている。そして今後、多様な材料が採用され、高速、高品質、高位置決め加工が必要不可欠な要素となる。ピアメカニクスは従来のFC-BGA用サブストレート穴明け製造技術をベースに、多様な材料への穴明け加工プロセスを開発している。本講演では各種材料レーザ加工を紹介するとともに、ピアメカニクスのレーザ加工技術、今後の取り組みを紹介する。

17:00-18:00 講師を交えた意見交換会

申し込み・問い合わせ 大阪大学 産業科学研究所 F3D実装協働研究所 先端半導体パッケージWG事務局
(TEL/FAX:06-6879-4295/E-mail:f3d@sanken.osaka-u.ac.jp)

主催:大阪大学 産業科学研究所 F3D実装協働研究所 後援:一般財団法人大阪大学産業科学研究協会